

SMD-Sicherung, 11 x 4.6 mm, Flink F, Telekom



IEC 60127-4 · 250 VAC · 250 VDC · Flink F

**Beschreibung**

- Direkt lötlbar auf Leiterplatte

Standards

- IEC 60127-4/2
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14
- Telcordia GR-1089
- UL 60950 / IEC 60950
- ITU-T K.20 und K.21
- TIA-968-A

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 106328
- UL Ausweisnummer: E41599
- CSA Ausweisnummer: 51172


Anwendungen

- xDSL und ADSL Produkte und Modems

Referenzen[Verpackungsdetails](#)**Weblinks**

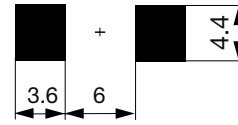
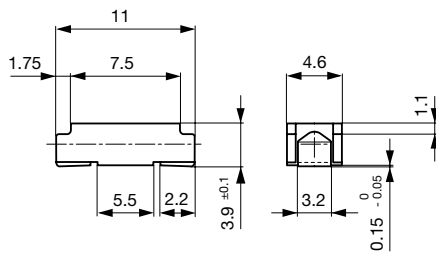
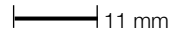
[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#)

Technische Daten

Nennspannung	250 VAC, 250 VDC
Nennstrom	0.25 - 3.15 A
Ausschaltvermögen	100 A
Charakteristik	Flink F
Montage	Leiterplatte, SMT
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 125 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Gehäuse	Thermoplast, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Kupferlegierung, verzinkt
Einzelgewicht	0.36 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 Typ, Strom, Charakteristik, Schaltvermögen, Prüfzeichen

Lötverfahren	Reflow, Welle
Lötbarkeit	245 °C / 3 sec nach IEC 60068-2-58, Test Td
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-58, Test Td
Stromfestigkeit	nach EIA/IS-722, Test 4.3.3
Last-/Feuchtigkeitstest	MIL-STD-202, Methode 103B 0.1*In @ 0.85 r.F. @ 85°C
Nässe-/Widerstandstest	MIL-STD-202, Methode 106E (50 Zyklen in Wärmekammer)
Festigkeit der Anschlüsse	MIL-STD-202, Methode 211A Biegung auf Platte, 1 mm, 1 Minute
Thermischer Schock	MIL-STD-202, Methode 107D (Luft Luft, 200 Zyk. von -55 bis +125°C)
Gehäusewiderstand	nach EIA/IS-722, Test 4.7 >100 MΩ (zw. Anschlüssen und Körper)
Mechanischer Schock	MIL-STD-202, Methode 213B (Schock 50 gn, halbe Sinus-Welle, 11 ms)
Hochfrequente Vibration	MIL-STD-202, Methode 204D Schock 20 gn, 20 min, 10-2 kHz, 12 Zyk.
Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel	MIL-STD-202, Methode 215A
Entflammbarkeit	min. UL 94V-1 (nach EIA/IS-722, Test 4.12)

Abmessungen



Lötflächen

Schmelzzeiten

Nennstrom I_n 1.25 x I_n min. 2.0 x I_n max. 10.0 x I_n min. 10.0 x I_n max.

0.25 A - 3.15 A	60 min	120 s	1 ms	10 ms
-----------------	--------	-------	------	-------

Varianten

Nennstrom [A]	Nennspannung [VAC]	Nennspannung [VDC]	Spannungsabfall 1.0 I _n typ. [mV]	Verlustleistung 1.25 I _n typ. [mW]	Schmelzintegral 10.0 I _n typ. [A ² s]	GR-1089-CORE [A]	UL60950	ITU - Lightning Surge [A]	ITU - Power Induc-	ITU - Power Contact [A]	Bestell-Nummer
0.25	250	250	1100	480	0.012	< 1.9	●	3.9		100.0	2070.0010.xx
0.315	250	250	1000	430	0.019	< 1.9	●	4.3	●	100.0	2070.0011.xx
0.4	250	250	230	190	0.02	3.1	●	5	●	100.0	2070.0012.xx
0.5	250	250	190	190	0.03	5.1	●	10	●	100.0	2070.0013.xx
0.63	250	250	170	230	0.07	9.2		16	●	100.0	2070.0014.xx
0.8	250	250	200	330	0.12	13.15		22	●	100.0	2070.0015.xx
1	250	250	170	390	0.23	13.15		27	●	100.0	2070.0016.xx
1.25	250	250	150	390	0.47	13.15		43	●	100.0	2070.0017.xx
1.6	250	250	150	490	0.84	13.15		67	●	100.0	2070.0018.xx
2	250	250	140	600	1.4	13.15		67	●	100.0	2070.0019.xx
2.5	250	250	130	670	2.6	13.15		67	●	100.0	2070.0020.xx
3.15	250	250	130	870	4.8	13.15		67	●	100.0	2070.0021.xx

1) 100 A @ 250 VAC/DC

Verpackungseinheit .xx = .11 Plastiktüte (100 St.)
 .xx = .24 Blistergurt 33 cm Spule (2000 St.)

[Kennlinien]

